



收藏本站 | English | 中国科学院

请输入关键字

查询

[首页](#)[所况介绍](#)[机构设置](#)[科研成果](#)[研究队伍](#)[招生招聘](#)[创新文化](#)[科学传播](#)[研究生培养](#)[党群园地](#)[产业体系](#)现在位置: [首页](#) > [新闻动态](#) > [业内信息](#)

## 台湾工研院与应用材料共同开发3D IC核心工艺

2009-11-05 | 编辑: | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

全球首座3D IC实验室预计将在明年年中登场, 中国台湾工研院与美商应用材料公司(Applied Material)宣布进行3D IC核心制程的客制化设备合作开发。这个弹性的开放制程平台, 将整合3D IC的主流技术穿透硅通孔(Through-silicon Vias, TSV)制程流程, 缩短集成电路及芯片开发时间, 协助半导体厂商迅速地将先进芯片设计导入市场, 进而大幅降低初期投资。

工研院主导的3D IC实验室将建构完整及多样化的制程能力, 整线系统包括蚀刻、实体气相沉积、化学机械研磨及等离子增强化学气相沉积四大设备, 这新设备将会用来制造与TSV技术相关的集成电路。

工研院与应用材料公司将针对先钻孔、后钻孔以及显露钻孔的TSV制程流程做技术整合, 提供最小线宽的蚀刻、最快速度的沉积、最稳定的制程研磨设备, 协助联盟的会员厂商迅速地将先进的芯片设计导入市场, 进而大幅降低开发时间及初期投资。

工研院院长李锺熙表示, 以往台湾地区半导体产业设备仅自行开发后端零组件, 前端设备多为进口, 此次在3D IC开发初期就有设备开发厂商投入, 表示我们在前端设备就能掌握相关制程技术, 可以为台湾半导体厂商主导3D IC关键制程, 并为半导体产业展开另一波机会。

工研院并表示, 与应用材料公司合作, 将有助于TSV技术的效能精进, 并降低成本, 带动3D IC相关产业加入, 加速台湾在3D IC自主制程技术开发, 先期掌握3D IC制程关键技术, 提升台湾半导体产业竞争优势。

(来源: 半导体国际 2009年10月19日)

[» 评论](#)

### 通知公告

MORE

- 中国科学院微电子研究所管理人员招聘启事
- 关于召开第六届研究生会换届选举的通知
- 关于举办中层干部执行力系列培训的通知
- 中国科学院微电子所冬季拔河跳绳比赛通知

### 新闻动态

- 图片新闻
- 头条新闻
- 综合新闻
- 学术活动
- 科研动态
- 通知公告
- 业内信息



中国科学院微电子研究所 版权所有单位名称:中国科学院微电子研究所 单位邮编: 100029  
单位地址: 北京市朝阳区北土城西路3号 电子邮件: [webadmin@ime.ac.cn](mailto:webadmin@ime.ac.cn)